

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月24日(24.08.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/157846 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) C09J 161/06 (2006.01)
C09J 7/35 (2018.01) C09J 163/00 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 115/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/005055
- (22) 国際出願日: 2023年2月14日(14.02.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-021992 2022年2月16日(16.02.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 金子 知世 (KANEKO Tomoyo); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 谷口 紘平 (TANIGUCHI Kohei); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 山本 和弘 (YAMAMOTO Kazuhiro); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 田澤 強 (TAZAWA Tsuyoshi); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: FILM-LIKE ADHESIVE AND METHOD FOR PRODUCING SAME, INTEGRATED DICING/DIE BONDING FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤及びその製造方法、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、並びに半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: The present invention discloses a film-like adhesive. The film-like adhesive contains an epoxy resin, a phenolic resin, an elastomer and an inorganic filler. The ratio of the epoxy groups in the epoxy resin to the hydroxyl groups in the phenolic resin is 1.2 or more.

(57) 要約: フィルム状接着剤が開示される。当該フィルム状接着剤は、エポキシ樹脂と、フェノール樹脂と、エラストマーと、無機フィラーとを含有する。フェノール樹脂の水酸基に対するエポキシ樹脂のエポキシ基の割合は1.2以上である。

WO 2023/157846 A1